



보도자료

EV Group, 세미콘 코리아 2026 에서 첨단 메모리 반도체 및 패키징을 위한 하이브리드·퓨전 본딩, 박막 분리 및 마스크리스 리소그래피 기술 소개

2026 년 2 월 9 일 – 첨단 반도체 설계 및 칩 통합 방식에 대한 혁신적인 공정 솔루션과 전문성을 제공하는 선도 기업인 EV Group(이하 EVG)은 오는 2 월 11 일부터 13 일까지 서울 코엑스 전시장에서 개최되는 세미콘 코리아 2026(SEMICON Korea 2026)에서 이종 집적(heterogeneous integration), 첨단 패키징 및 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조를 위한 최신 솔루션을 선보일 예정이라고 밝혔다(부스 번호: DS26). 이번에 소개할 솔루션에는 EVG 의 GEMINI® FB 양산용 웨이퍼 본딩 시스템, EVG®40 D2W 다이-투-웨이퍼 오버레이 계측 시스템, IR LayerRelease™ 박막 분리 기술 플랫폼, 그리고 EVG 의 고처리량 LITHOSCALE® XT 마스크리스 노광 시스템이 포함된다.

EVG 의 장비 및 공정 솔루션은 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯한 첨단 메모리 디바이스는 물론, 센서와 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조를 포함한 첨단 패키징 및 MEMS 애플리케이션 전반에서 제조 기술을 발전시키는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 또한 EVG 는 세미콘 코리아 2026 에서 자사의 LayerRelease 박막 분리 기술 플랫폼 및 마스크리스 노광 플랫폼에 초점을 맞춘 두 개의 기술 세션에도 참여할 예정이다.

EVG 의 게오르크 베르거(Georg Berger) 아태지역 세일즈 매니저는 “한국의 기술 기업과 연구 기관들은 전세계 반도체 산업, 특히 첨단 메모리, 3D 집적 및 패키징 기술 분야의 혁신을 지속적으로 선도해 왔다”며, “EVG 는 현장에서 검증된 솔루션과 한국 내 강력한 애플리케이션 및 서비스 역량을 통해 한국의 고객과 파트너를 지원하고 있다는 점을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다.

EVG 코리아의 운영식 지사장은 “세미콘 코리아와 같은 행사는 우리에게 하이브리드 본딩, 리소그래피, 박막 분리 분야에서 EVG 의 최신 기술을 소개하고, 반도체 제조의 미래를 만들어가는 업계 리더들과 협력할 수 있는 중요한 기회를 제공한다”고 말했다.

첨단 메모리 및 3D 집적을 위한 고수율 하이브리드 본딩 지원

웨이퍼-투-웨이퍼(W2W) 하이브리드 본딩은 차세대 3D NAND 및 DRAM 양산의 수율을 높이고 확장성을 향상하는 데 필수적인 기술로, 이를 위해서는 서브마이크론 수준의 정렬 정확도와 우수한 본딩 강도가

필요하다. 다이-투-웨이퍼(D2W) 하이브리드 본딩은 칩렛 집적, HBM 스택, 3D 시스템온칩(SoC) 집적 공정을 가능하게 하는 핵심 기술이다. EVG 는 W2W 본딩을 위한 완전한 하이브리드 본딩 공정 플로우를 제공할 뿐만 아니라, D2W 하이브리드 본딩을 위한 표면 준비, 세정, 집합 다이 전사(collective die transfer), 고정밀 정렬 기능 등 포괄적인 기능들을 제공한다. 최근 발표한 EVG40 D2W 는 D2W 본딩을 위한 고정밀 인라인 오버레이 계측을 제공하여, 고객이 다이 배치 정확도와 성능을 극대화할 수 있도록 실시간 피드백 루프를 지원한다.

첨단 패키징 및 프로브 카드 애플리케이션을 위한 마스크리스 노광 리소그래피

EVG 의 LITHOSCALE 플랫폼은 고해상도 스티치리스(stitch-free) 패터닝, 강력한 디지털 리소그래피, 그리고 우수한 처리량 성능을 결합해 다양한 패키징 및 MEMS 애플리케이션을 위한 매력적인 리소그래피 솔루션을 제공한다. 이 플랫폼은 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 디바이스용 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP), 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드, 첨단 이미징 센서, 그리고 보안 및 자동차 애플리케이션을 위한 다이 추적성(die traceability) 등 다양한 애플리케이션에 활용된다. 또한 EVG 의 MLE™(Maskless Exposure) 기술은 빠른 노광 속도, 유연한 데이터 처리, 확장 가능한 아키텍처를 갖추고 있어, 고해상도 패터닝과 신속한 설계 변경이 요구되는 양산 환경에 매우 적합하다. 이와 함께 최근 새로 선보인 LITHOSCALE XT 신형 시스템은 기존 업계 벤치마크였던 LITHOSCALE 시스템 대비 최대 5 배 향상된 처리량 성능을 제공하여, 이종 집적 대량 생산(high-volume manufacturing) 애플리케이션에 디지털 리소그래피를 구현할 수 있게 해준다.

IR LayerRelease 를 통한 초박형 다이 스택 구현

EVG 의 IR LayerRelease 기술은 프론트엔드 공정과 완전히 호환되는 박막 분리 기술로, 실리콘이 투과 가능한 적외선(IR) 레이저를 사용하는 것이 특징이다. 특수하게 형성된 무기질 레이어를 사용하는 이 기술은 나노미터 수준의 정밀도와 업계 최고 수준의 디본딩 처리량으로, 실리콘 캐리어로부터 초박형 필름 또는 레이어를 레이저로 선택적으로 분리할 수 있도록 한다.

따라서 IR LayerRelease 를 활용하면 첨단 패키징에서 유리 기판을 사용할 필요가 없고, 3D-IC 및 3D 순차 집적 애플리케이션을 위한 완전히 새로운 공정 플로우가 가능해, 실리콘 캐리어 상의 초박형 레이어에 대해서도 하이브리드 및 퓨전 본딩이 가능해진다.

세미콘 코리아 2026 기술 발표

EVG 는 올해 세미콘 코리아 STS(SEMI Technology Symposium) 프로그램에도 참여하며, 발표 주제와 일정은 다음과 같다:

- **“High Throughput Digital Lithography Development Enables AI and HPC Device Integration”** (S1 Advanced Lithography Session, Wed., Feb. 11, 3:15-3:40pm, Room #307) – presented by Dr. Ksenija Varga, Business Development Manager

- “EVG LayerRelease Technology – Key Innovations in Carrier Systems: Addressing D2W and W2W Stacking Requirements” (S6 Advanced Packaging Session, Thu., Feb. 12, 5:25-5:50pm, Room #317) – presented by Dr. Thomas Uhrmann, Vice President of Sales

세미콘 코리아 2026 에서 EVG 를 만나보세요

전시회 기간 동안 EVG 부스(DS26)에 방문하면 하이브리드 본딩, 마스크리스 리소그래피, 초박형 박막 분리 기술을 선도하는 EVG 의 혁신적인 솔루션을 직접 경험할 수 있으며, EVG 담당자와 상담 기회도 가질 수 있다.

EV Group(EVG) 소개

EV Group(EVG)은 첨단 반도체 설계 및 칩 통합 방식을 위한 혁신적인 공정 솔루션과 전문성을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. EVG 는 가장 먼저 새로운 기술을 탐색하고 마이크로·및 나노 제조 기술의 차세대 응용 분야를 지원한다는 비전을 바탕으로, 고객이 새로운 제품 기획을 성공적으로 상용화할 수 있도록 돕고 있다. 웨이퍼 본딩, 리소그래피, 초박형 웨이퍼 처리 및 계측 장비를 포함한 EVG 의 양산 지원 제품군은 반도체 프런트엔드 스케일링, 3D 집적 및 첨단 패키징뿐만 아니라 기타 전자 및 광학 애플리케이션의 발전을 지원한다 EVG 에 대한 보다 자세한 정보는 www.EVGroup.com 에서 확인할 수 있다.

보도자료 문의:

Clemens Schütte
 Director, Marketing and Communications
 EV Group
 Tel: +43 7712 5311 0
 E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
 Principal
 Open Sky Communications
 Tel: +1.415.519.3915
 E-mail: dmoreno@openskypr.com

EVG 코리아 문의
 EV Group Korea Ltd.
 Tel: 02-3218-4413
 E-mail: Sales@EVGroup.co.kr

박윤희 실장
 페리엔
 Tel: 02-565-6625
 E-mail: desiree@perrien.co.kr

###